

マルチチャンバ型成膜装置 ENTRON™-EX W300

Al、Cu、高融点金属メタル配線工程に多くの実績を持つ、枚葉式マルチチャンバ対応プラットフォームです。次世代プロセスに適応するSIS (Self-Ionized Sputter) -PVD、メタルCVD/ALD、DRY前処理モジュールの組み合わせによって、最適なコストパフォーマンスを実現します。



■ 特長

- フレキシブルなモジュール構成が可能
 - PVDとCVD/ALDプロセスモジュールのインテグレーションに対応
 - Ti/TiNバリアメタル、AL、Cu配線、Co/Niサリサイドなど様々なアプリケーションに対応
 - 多品種のデバイス生産に対応
- 標準10室のプロセスモジュール搭載が可能 (タンデム仕様)
- 独立した加熱/冷却専用モジュール2室の搭載が可能
- シングル仕様/タンデム仕様プラットフォームの選択が可能

■ 用途

- 最先端半導体メモリ、ロジック
- パワーデバイスなど